放射光を用いたシロキサン含有ブロック共重合化ポリイミドの 2113 相分離構造と特異的な低熱膨張挙動の解析

東工大物質理工¹·山形大院有機²·JSR(株)³ 〇百瀬 敦都¹·松田 直樹²·東原 知哉²·丸山 洋一郎³·藤冨 晋太郎³·安藤 慎治¹·石毛 亮平¹

【緒言】 ポリイミド(PI)はその優れた耐熱性や電気 絶縁性から、電子回路基板の絶縁層などに利用され、 近年のフレキシブルデバイスの発展に伴い、より高 い靭性が要求されている.これに有効な手段として, 極めて柔軟な高分子であるポリジメチルシロキサン

Fig. 1 Chemical structure of PI/PDMS.

PDMS

(PDMS)との共重合が検討されてきた.しかし高分子の中でもとりわけ熱膨張率が大きい PDMS との共 重合化は PI の熱寸法安定性の低下につながる. 一方, 当研究室のこれまでの検討から, 含フッ素全芳香 族 PI, PMDA-TFDB と PDMS のマルチブロック共重合体 (PI/PDMS, Fig. 1) が, PMDA-TFDB 単独重合 体(Homo-PI)の結晶格子に比べてさらに小さい体積熱膨張率(CVE)を示すことを見出している.本研究 では、PDMS の共重合による PI の靭性向上を目指すとともに、放射光 X 線を用いて昇温過程における PI/PDMSの構造変化を解析し、PI/PDMS が示す低 CVE の発現機構の解明を試みた.

PDMS と PAA を共重合化した前駆 【実験】 体溶液(PDMSの重量分率/WPDMs:4,8,12,16,20, 24, 28, 32wt%, PDMS \mathcal{O} Mw \wr 4400g mol⁻¹ \wr 固定)をガラス基板上にブレードコート後, 70°C で乾燥させ, 400°C で熱処理し PI/PDMS 膜を作製した(乾燥,熱処理は窒素雰囲気下で 実施). W_{PDMS} が 8wt%の PI/PDMS 膜 (PI/PDMS 8w)を短冊状に切り出し引張試験を 行った. īた, 無染色 PI/PDMS 8w の断面を透 過型電子顕微鏡(TEM)で観察した.各 PI/PDMS Homo-PI and PI/PDMS_8wt film.

膜の面内および面外方向の線熱膨張係数 CTE// および CTE」を, TMA 法および近赤外干渉分光法によりそれぞれ計測し, それらの総和から CVE を評 価した.温度可変小角 X 線散乱(VT-SAXS)測定を行い,昇降温中における PI/PDMS 膜の偏析構造の変 化を調査した. KI 水溶液を用いた浮沈法により各 PI/PDMS 膜の密度を測定し、さらに PI/PDMS 膜と

Homo-PI 膜の密度,および W_{PDMS}から, PI/PDMS 中における PDMS の密度を算出した. PI/PDMS 8wt は Homo-PI と比較し, 破断強度は約 15%, 破断伸びは約 40% 増加した 【結果と考察】 とともに,同程度のヤング率を示した(Fig. 2).また, PI/PDMS 膜の CVE は W_{PDMS} < 20wt%までは W_{PDMS} の増加と共に低下,それ以上では上昇し,W_{PDMS} が 24wt%以下の膜において Homo-PI 膜の CVE に比べ 有意に小さい値を示した(Fig.3). PI/PDMS 8wt 膜断面の TEM 像(Fig.4)には, 明るい灰色の背景(PI 相)

の中に暗い島状の領域(PDMS 相)が観測され, PDMS 相が面内(In-plane)方向 に沿って一定間隔で配列している相分離構造の形成を確認した. PI/PDMS 8wt に対する VT-SAXS 測定によって得られた SAXS 強度曲線, および不変量 Q の 温度変化を Fig. 5 に示す. 室温において相分離の周期構造に起因する散乱ピ ークが見られ, その長周期長(約30nm)は TEM 観察で評価した寸法と一致し た. また, Q は配向に依存しない積分強度に対応し, 相分離構造を形成する両 相の形状,体積分率,および電子密度差 Δρ の関数である(ラメラ状周期の場 合 Q=Δρ2φ(1-φ), φ は体積分率).昇温により SAXS 強度曲線はその形状を維 持しつつ, 強度および Q が顕著に減少し, PI/PDMS は昇温過程で相分離形態 を維持しつつ PI, PDMS 両相間の電子密度差が減少することが示唆された.

密度測定によって算出した PI/PDMS 中の PDMS 密度は、いずれの試料においても PDMS 単体の密 度(0.97)を下回り、WPDMs との相関が WPDMs vs. CVE の傾向とよく一致することが判明した(Fig. 6). 以上のことから、PI/PDMS の低 CVE の発現 は、昇温により PI、PDMS 両相が相分離界面にお いて部分相溶化したこと、もしくは室温において 過剰に低密度化した PDMS が昇温により高密度化 したことに起因すると考えた.当日は,PDMS 分 子量を調製した PI/PDMS についても報告する.



 $Q = \Phi^2 \phi(1 - \phi)$



00 nm





0.86

Analysis of Phase-Separated Structure and Unique Low Thermal Expansion Behavior of Siloxane-Containing Block Copolymerized Polyimides Using Synchrotron Radiation <u>Atsuto MOMOZE¹</u>, Tomoya HIGASHIHARA², Naoki MATSUDA², Yoichiro Maruyama³, Shintaro Fujitomi³, Shinji ANDO¹, Ryohei ISHIGE¹, (¹Dept. Chem. Sci. Eng. Tokyo Institute of Technology, 2-12-1-E4-5, Ookayama, Meguro-ku, Tokyo, 152-8552 Japan, ²Grad. Sch. Org. Mater. Sci., Yamagata University, 4-3-16 Jonan, Yonezawa, Yamagata 992-8510 Japan, ³JSR Corp. 100 Kawajiri-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108552, Japan) TEL & FAX: +81-3-5734-2889, E-mail: momoze.a.aa@m.titech.ac.jp

10

10 10³ 10²





Fig. 2 Mechanical property of

Fig. 3 CVE of PI/PDMS depend on weight fraction of PDMS.